



平成 28 年 3 月 28 日

各 位

会社名： ミライアル株式会社
代表者： 代表取締役社長 山脇 秀夫
(コード番号 4238)
問合せ先： 専務取締役 兵部 匡俊
(TEL 03-3986-3782)

定款一部変更に関するお知らせ

平成 28 年 2 月 15 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 28 年 4 月 26 日開催予定の第 48 回定時株主総会に付議することを決議し、これについて同日公表いたしました。その後、平成 28 年 3 月 25 日開催の取締役会において、更に下記の通り変更することとしましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更の目的

平成 28 年 2 月 15 日開催の取締役会において、現行定款第 2 条（目的）のうち「損害保険代理業」を削除することといたしておりましたが、平成 28 年 3 月 25 日開催の取締役会において、今後の事業計画を点検・再検討した結果、当該事業目的を現状どおり残すことといたしました。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(「今回改定案」の二重下線部が「平成 28 年 2 月 15 日改定案」に対する今回変更部分です。)

現行	平成 28 年 2 月 15 日改定案	今回改定案
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
(商 号) 第 1 条 (条文省略)	(商 号) 第 1 条 (現行どおり)	(商 号) 第 1 条 (現行どおり)
(目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 合成樹脂製品の製造販売 2. 合成樹脂製品用金型の製造販売	(目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 合成樹脂製品の製造販売 2. 合成樹脂製品用金型の製造販売	(目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 合成樹脂製品の製造販売 2. 合成樹脂製品用金型の製造販売

<p>3. 半導体、液晶、エレクトロニクス等の製造販売</p> <p>4. 半導体試験装置、半導体検査装置および半導体搬送装置を含む半導体製造装置の製造販売</p> <p>5. 環境にかかる水、ガス等の浄水処理装置等の製造販売</p> <p><u>6. 損害保険代理業</u> (新設)</p> <p>7. 前各号に付帯関連する一切の事業</p>	<p>3. 半導体、液晶、エレクトロニクス等の製造販売</p> <p>4. 半導体試験装置、半導体検査装置および半導体搬送装置を含む半導体製造装置の製造販売</p> <p>5. 環境にかかる水、ガス等の浄水処理装置等の製造販売</p> <p>(削除)</p> <p><u>6. 不動産の賃貸、管理</u></p> <p>7. 前各号に付帯関連する一切の事業</p>	<p>3. 半導体、液晶、エレクトロニクス等の製造販売</p> <p>4. 半導体試験装置、半導体検査装置および半導体搬送装置を含む半導体製造装置の製造販売</p> <p>5. 環境にかかる水、ガス等の浄水処理装置等の製造販売</p> <p><u>6. 損害保険代理業</u></p> <p><u>7. 不動産の賃貸、管理</u></p> <p><u>8. 前各号に付帯関連する一切の事業</u></p>
---	--	--

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 (予定)

平成 28 年 4 月 26 日

定款変更の効力発生日 (予定)

平成 28 年 4 月 26 日

以 上